



ZT2S 模组规格书

文档版本: 20210910

[查看在线版本](#)

目录

1 产品概述	2
1.1 特性	2
1.2 应用领域	2
1.3 更新说明	2
2 模组接口	3
2.1 引脚分配	3
2.2 引脚定义	4
3 电气参数	6
3.1 绝对电气参数	6
3.2 正常工作条件	6
3.3 连续发射和接收时功耗	6
3.4 工作电流	7
4 射频参数	8
4.1 基本射频特性	8
4.2 发射性能	8
4.3 接收性能	8
5 模组上电时序要求	10
6 天线信息	12
6.1 天线类型	12
6.2 降低天线干扰	12
7 封装信息及生产指导	13
7.1 机械尺寸	13
7.2 侧视图	15
7.3 推荐封装	15
7.4 生产指南	16
7.5 推荐炉温曲线和温度建议	17
7.6 存储条件	18
8 模组 MOQ 与包装信息	20

9 附录：声明	21
---------	----

ZT2S 是由涂鸦智能开发的一款 ZigBee 模组。它由一颗高集成度的无线射频处理器芯片 Z2 和少量外围器件构成。ZT2S 内嵌低功耗的 32 位 CPU 内核，1024 KByte flash，64KB RAM 和丰富的外设资源。

1 产品概述

用户可以基于 ZT2S 开发满足自己需求的 Zigbee 产品。

1.1 特性

- 内置低功耗 32 位 CPU 处理器
- 主频支持 48 MHz
- 宽工作电压：1.8 V-3.6 V
- 外设：5×GPIOs, 1×UART, 1×ADC
- Zigbee 连通性
 - 支持 802.15.4 MAC/PHY
 - 工作信道 11 - 26@2.400-2.483GHz, 空口速率 250Kbps
 - 最大 +10dBm 的输出功率, 输出功率动态 >35dB
 - 内置板载 PCB 天线
 - 板载 PCB 天线, 天线增益 2 dBi
 - 工作温度: -40°C to 85°C
 - 支持硬件加密, 支持 AES 128

1.2 应用领域

- 智能楼宇
- 智慧家居/家电
- 智能插座、智慧灯
- 工业无线控制
- 婴儿监控器
- 智能公交

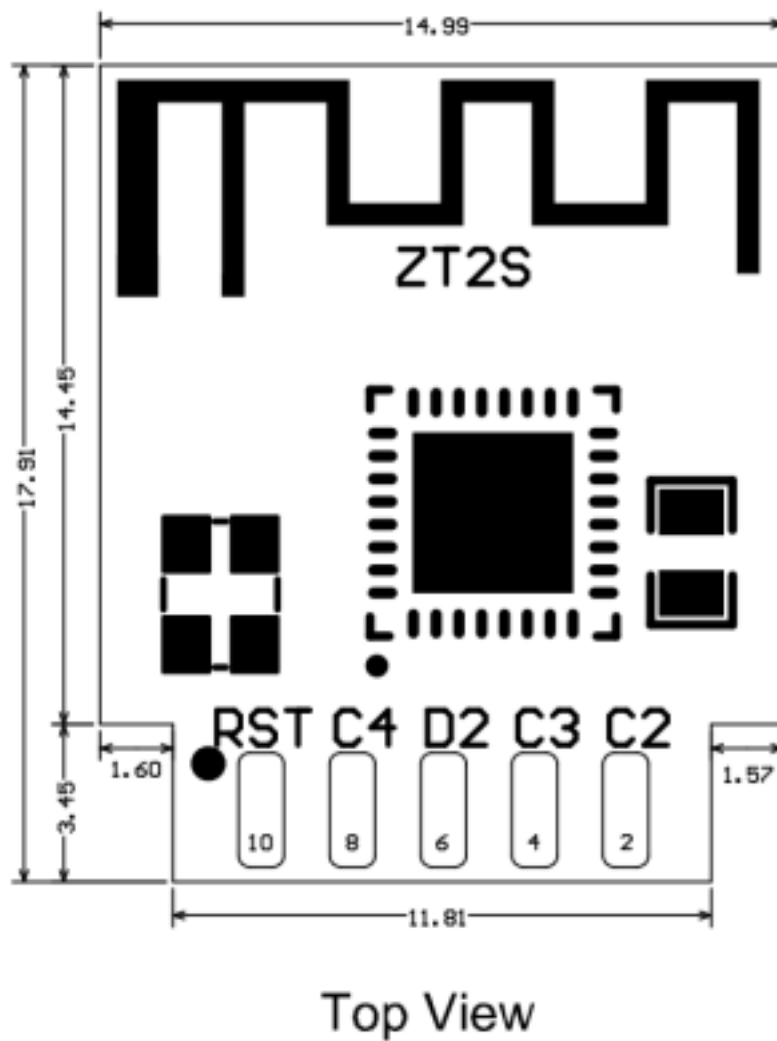
1.3 更新说明

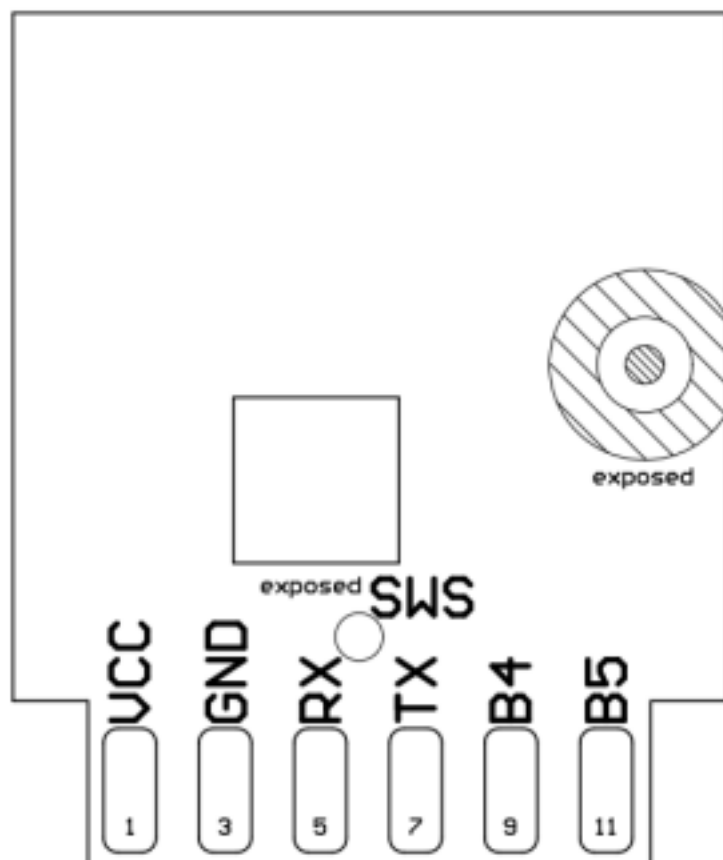
更新日期	更新内容	更新后版本
2021-07-15	新建文档	V1.0.0

2 模组接口

2.1 引脚分配

ZT2S 有 2 排引脚, 共计 11 个, 引脚间距 2 mm。ZT2S 尺寸: 14.99 (± 0.35) mm (W) \times 17.90 (± 0.35) mm (L) \times 2.80 (± 0.15) mm (H) 封装下图所示, 其中 PCB 厚度 0.8 mm \pm 0.1 mm:





Bottom View

2.2 引脚定义

引脚序号	符号	IO 类型	功能
1	VCC	P	模组电源引脚（典型值 3.3 V）
2	C2	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 TL_C2（Pin22）

引脚序号	符号	IO 类型	功能
3	GND	P	模组电源参考地
4	C3	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 TL_C3 (Pin23)
5	RX	I/O	Uart_RXD，对应 IC 的 B7 (Pin17)
6	D2	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 TL_D2 (Pin31)
7	TX	I/O	Uart_TXD，对应 IC 的 B1 (Pin6)
8	C4	I/O	ADC 端口，对应 IC 的 TL_C4 (Pin24)
9	B4	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 TL_B4 (Pin14)
10	RST	I	硬件复位引脚（低电平有效），对应 IC 的 RESETB (Pin25)
11	B5	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 TL_B5 (Pin15)
12	SWS	I/O	烧录测点，对应对应 IC 的 SWS (Pin5)

- P 表示电源引脚，I/O 表示输入输出引脚。
- 如对 PWM 输出控制的灯色有自己的需求，请与我司商务联系。

3 电气参数

3.1 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	工作温度	-5	150	°C
VCC	供电电压	-0.3	3.6	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-	2	KV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-	0.5	KV

3.2 正常工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-40	-	85	°C
VCC	工作电压	1.9	3.3	3.6	V
VIL	IO 低电平输入	-	-	IOVDD*0.3	V
VIH	IO 高电平输入	IOVDD*0.7	-	-	V
VOL	IO 低电平输出	-	-	IOVDD*0.2	V
VOH	IO 高电平输出	IOVDD*0.8	-	-	V

3.3 连续发射和接收时功耗

工作状态	模式	速率	发射功率/接收	平均值	峰值 (典型值)	单位
发射	-	250Kbps	+0dBm	4.7	22.91	mA
发射	-	250Kbps	+10dBm	9.25	38.78	mA
接收	-	250Kbps	连续接收	7.35	7.61	mA

3.4 工作电流

工作模式	工作状态, Ta=25℃	平均值	最大值 (典型值)	单位
快连配网状态	模组处于快连配网状态	9.15	9.49	mA
网络连接状态	模组处于联网工作状态	8.95	9.15	mA
深度睡眠模式	深度睡眠模式, 保留 32KB SRAM	2.8	-	uA

4 射频参数

4.1 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.405~2.480GHz
Zigbee 标准	IEEE 802.15.4
数据传输速率	250Kbps
天线类型	PCB 天线, 天线增益 2dBi

4.2 发射性能

TX 连续发送性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
最大输出功率 (250Kbps)	-	10	-	dBm
最小输出功率 (250Kbps)	-	-25	1	dBm
输出功率调节步 进	-	0.5	1	dBm
输出频谱临道抑 制度	-	-31	-	dBc
频率误差	-10	-	10	ppm

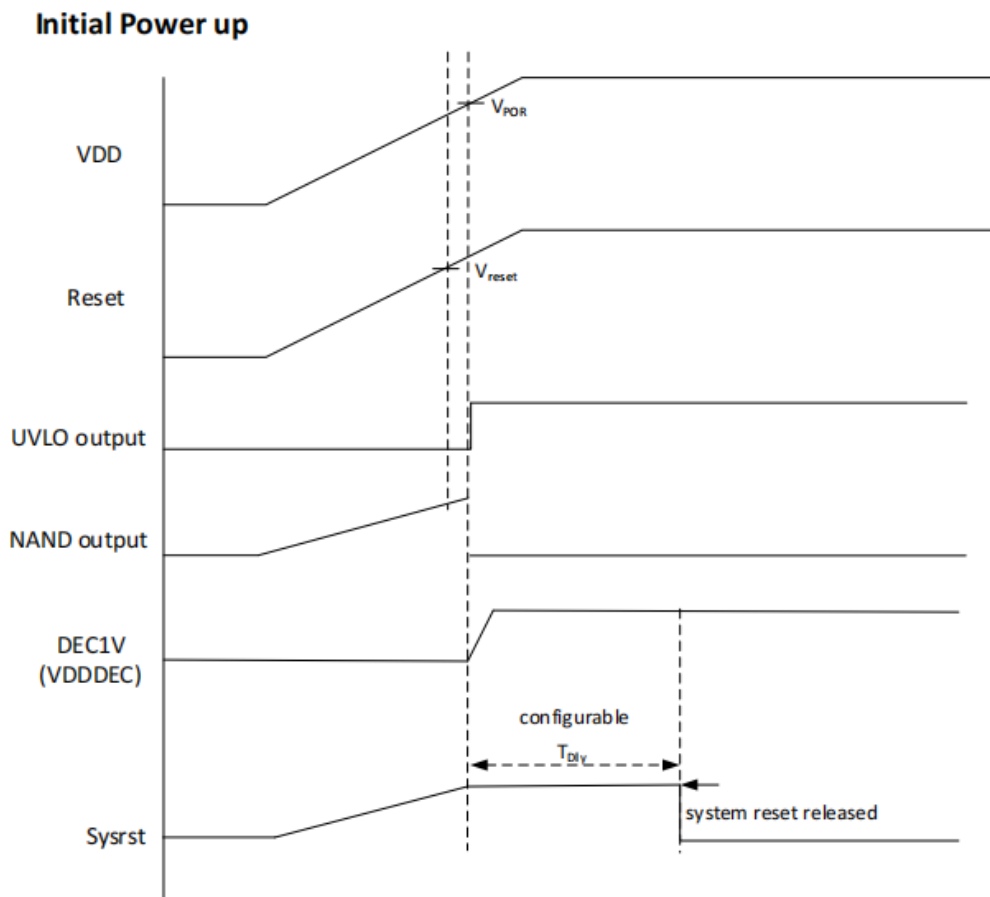
4.3 接收性能

RX 灵敏度

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%, RX 灵敏度 (250Kbps)	-102	-101	-99	dBm

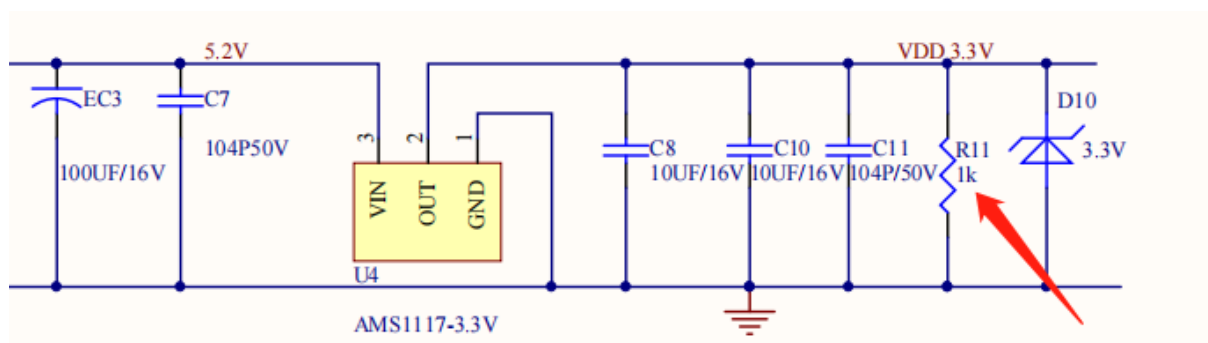
5 模组上电时序要求

Figure 2-4 Initial Power-up sequence

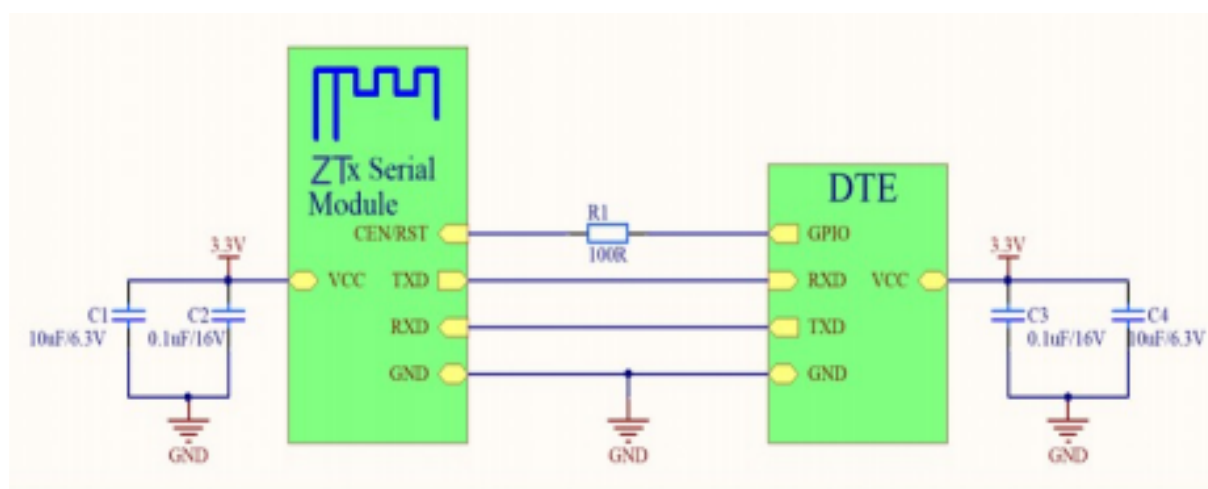


Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{POR}	VDD voltage when V_{UVLO} turns to high level		1.62		V
V_{Pdn}	VDD voltage when V_{UVLO} turns to low level		1.55		V
Supply rise time (from 1.6V to 1.8V)		t_r	10	ms	

Z2 芯片对上电时序有要求，在上电过程中 RST 引脚达到 1.62V 以后系统开始启动，这个时候 VCC 需要在 10ms 内达到 1.8V 以上。由于 RST 引脚有 RC 链路，故裸模组在 RST 达到 1.62V 的时候 VCC 已经超过 1.8V。Z2 芯片模组对接的电源驱动如果存在大电容的一些充放电情况下，若模组电压未完全放电到 0.6V 以下，模组再启动的话会有死机风险；要求模组 VCC_3.3V 供电引脚需要接 1K 的假负载用来快速释放电能。可参考下面的部分电源驱动链路



由于模组串口对接有倒灌电压，可通过对模组 CEN 或 RST 引脚拉低，降低模组不工作时的功耗来实现整机低功耗



如图所示，MCU 通过 GPIO 口控制模组的 CEN 或 RST 引脚，实现对模组的通断电操作。当有数据需要上报时，GPIO 口输出高电平，模组上电，串口通信建立连接，MCU 通过模组将数据同步到云端和客户端。当数据上报完成后，GPIO 口输出低电平，模组处在复位状态，模组低功耗。缺点：模组 CEN 或 RST 引脚内部有 10K 上拉电阻，当模组处在复位状态时，模组的输入电流仍有 330uA。

6 天线信息

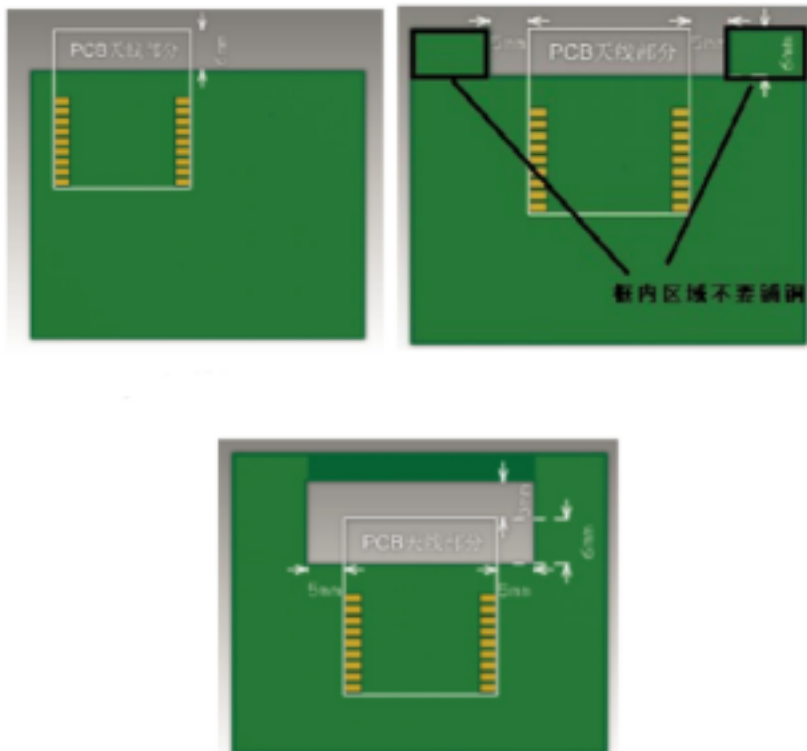
6.1 天线类型

ZT2S 使用的是板载 PCB 天线，天线增益 2 dBi。

6.2 降低天线干扰

为确保 RF 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件的距离至少保持 15mm 以上。如果使用环境的天线周边包裹金属材料等，会极大地衰减无线信号，进而恶化射频性能。成品设计时，注意给天线区域预留出足够的空间。

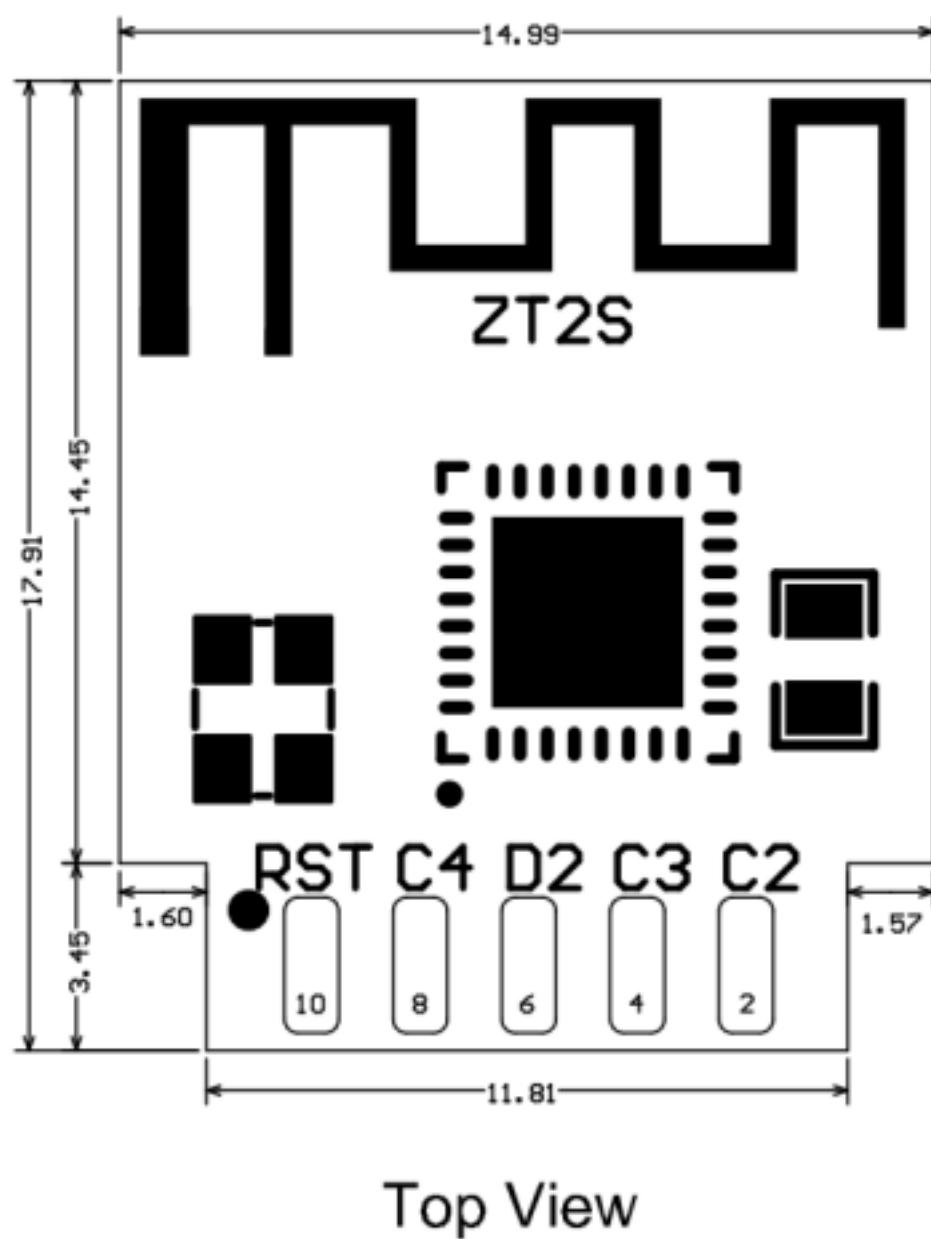
用户 PCB 板在天线区域勿走线甚至覆铜，以免影响天线性能。

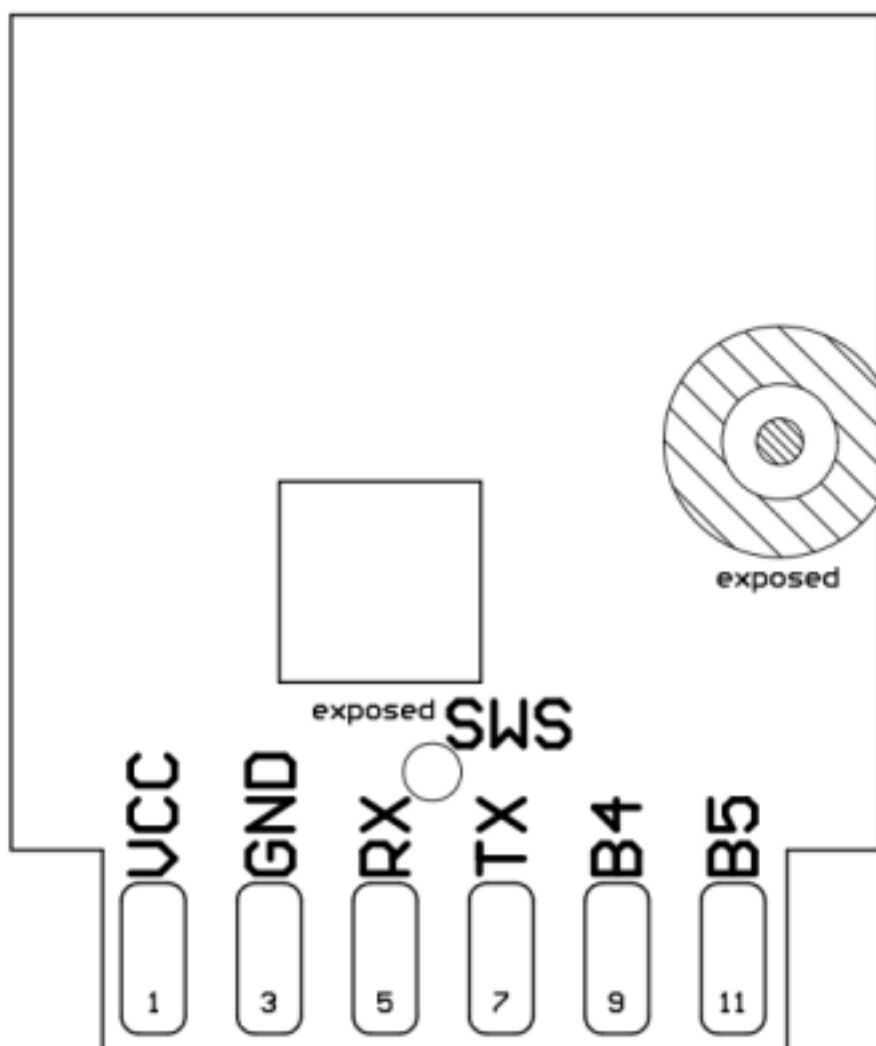


7 封装信息及生产指导

7.1 机械尺寸

ZT2S 模组的机械尺寸（单位：mm）如下图所示：





Bottom View

7.2 侧视图



单位: mm

模组外形公差: $\pm 0.35\text{mm}$

板厚公差: $\pm 0.1\text{mm}$

屏蔽盖高度公差: $\pm 0.05\text{mm}$

Unit: mm

Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$

PCB thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

Shield cover height tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

Side View

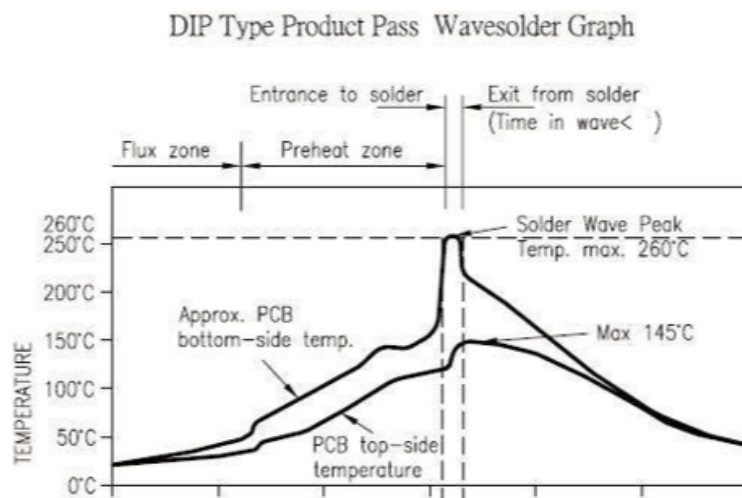
7.3 推荐封装

推荐封装 (单位: mm):

- 涂鸦出厂的模组在遇到以下可能受潮的情况下，需要进行烘烤：
 - 拆封前发现真空包装袋破损
 - 拆封后发现包装袋内没有湿度指示卡
 - 拆封后如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色
 - 拆封后总暴露时间超过 168 小时
 - 从首次密封包装之日起超过 12 个月
- 烘烤参数如下：
 - 烘烤温度：卷盘包装 60℃，小于等于 5%RH；托盘包装 125℃，小于等于 5%RH（耐高温托盘非吸塑盒拖盘）
 - 烘烤时间：卷盘包装 48 小时，托盘包装 12 小时
 - 报警温度设定：卷盘包装 65℃，托盘包装 135℃
 - 自然条件下冷却到 36℃ 以下后，即可进行生产
 - 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完，请再次进行烘烤
 - 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用波峰焊接工艺焊接此批次模组，因模组为 3 级湿敏器件超过允许的暴露时间很可能受潮，进行高温焊接时可能导致器件失效或焊接不良。
- 在整个生产过程中请对模组进行静电放电（ESD）保护。
- 为了确保产品的良好品质，生产时需重点关注助焊剂的喷涂量。波峰高度，波峰焊锡缸内的锡渣和铜含量是否超标，波峰焊接治具开窗和治具厚度是否合适以及波峰焊接炉温曲线的合理性。

7.5 推荐炉温曲线和温度建议

请参考波峰焊接炉温建议进行炉温设定，峰值温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，波峰焊接温度曲线如下图所示：



焊接温度建议:

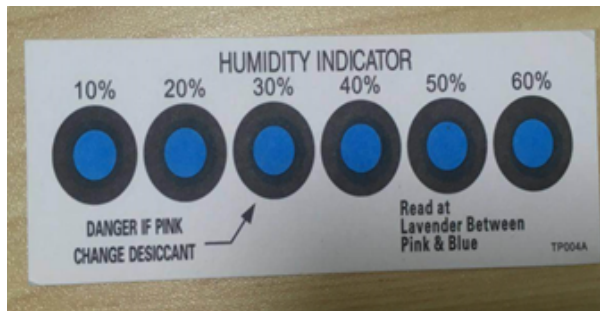
波峰焊接炉温曲线建议


手工焊接温度建议

预热温度	80-130°C	焊接温度	360°C±20°C
预热时间	75-100S	焊接时间	小于 3S/点
波峰接触时间	3-5S	NA	NA
锡缸温度	260±5°C	NA	NA
升温斜率	≤2°C/S	NA	N 涂鸦出厂的模组存储条件如下:

7.6 存储条件

- 使用防潮袋真空包装，储存在温度 < 40°C、湿度 < 90%RH 的环境中。
- 干燥包装的产品，保质期为从包装密封之日起 12 个月的时间。
- 密封包装内装有湿度指示卡：



	警示	等级 (MSL)
	本防潮袋装有 潮湿敏感器件	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">3</div> 如果缺省， 见相邻的条码标签
<p>1. 经计算密封袋内器件的保存期限：在$<40^{\circ}\text{C}$及$<90\%$相对湿度 (RH)条件下为12个月</p> <p>防潮袋密封日期：_____ 详见生产日期 _____</p> <p style="text-align: center;">如果缺省，见相邻的条码标签</p>		
<p>2. 封装本体峰值温度：_____ 260 $^{\circ}\text{C}$</p> <p style="text-align: center;">如果缺省，见相邻的条码标签</p>		
<p>3. 打开袋后，将要采用再流焊接或者其它高温工艺加工的器件必须</p> <p>a) 在车间环境$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%$ RH条件下，在 _____ 168 _____ 小时 内贴装，或 b) 按照J-STD-033贮存 如果缺省，见相邻的条码标签</p>		
<p>4. 贴装前，器件要求烘烤，如果：</p> <p>a) 在$23\pm 5^{\circ}\text{C}$下读取时，对于等级为2a-5a级的器件，湿度指示卡读数$>10\%$；或者对于等级为2级的器件，湿度指示卡读数$>60\%$</p> <p>b) 上述的3a或者3b条件不满足</p>		
<p>5. 如果要求烘烤，参见IPC/JEDEC J-STD-033中的烘烤程序。</p> <p>注 1: IPC/JEDEC J-STD-020规定了等级和封装本体温度</p>		

8 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	每个卷盘存放模组数	每箱包装卷盘数
ZT2S	4400	载带卷盘	1100	4

9 附录：声明

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used following the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled rolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Important Note

This radio module must not be installed to co-locate and operating simultaneously with other radios in the host system except following FCC multi-transmitter product procedures. Additional testing and device authorization may be required to operate simultaneously with other radios.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are

country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end-user.

The host product manufacturer is responsible for compliance with any other FCC rules that apply to the host not covered by the modular transmitter grant of certification. The final host product still requires Part 15 Subpart B compliance testing with the modular transmitter installed.

The end-user manual shall include all required regulatory information/warnings as shown in this manual, including “This product must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body” .

This device has got an FCC ID: 2ANDL-ZT2S. The end product must be labeled in a visible area with the following: “Contains Transmitter Module FCC ID: 2ANDL-ZT2S” .

This device is intended only for OEM integrators under the following conditions: The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users, and 2) The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

As long as the 2 conditions above are met, further transmitter tests will not be required. However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed.

Declaration of Conformity European Notice



Hereby, Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd declares that this module product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU. A copy of the Declaration of conformity can be found at <https://www.tuya.com>.



This product must not be disposed of as normal household waste, in accordance with the EU directive for waste electrical and electronic equipment (WEEE-2012/19/EU). Instead, it should be disposed of by returning it to the point of sale, or to a municipal recycling collection point.

The device could be used with a separation distance of 20cm to the human 全